

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

## 新聞稿

# 華虹半導體二零一六年第三季度業績公佈

*所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。*

*本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。*

中國香港 — 2016年11月3日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一六年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

### 二零一六年第三季度主要財務指標 (未經審核)

- 銷售收入再創歷史新高，達 1.853 億美元，環比增長 4.3%，同比增長 7.5%。
- 毛利率升至 31.1%，環比上升 0.3 個百分點，同比上升 0.5 個百分點。
- 期內溢利 2,980 萬美元，環比下降 23.5%，同比下降 1.4%。
- 每股盈利 0.03 美元，環比下降 0.01 美元，同比持平。

### 二零一六年第四季度指引

- 我們預計銷售收入與第三季度持平。
- 我們預計毛利率約為 31%。

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對業績評論道：

“本季度銷售收入再創歷史新高，達 1.853 億美元，環比增長 4.3%。受益于近乎滿產的產能利用率，毛利率上升到 31.1%。淨利潤和淨利潤率分別為 2,980 萬美元和 16.1%。我們持續進行產能擴充，至本季度末，月均產能已達到 15.3 萬片晶圓。由於客戶需求旺盛，新建產能已快速啓用。

雖有季節性調整因素，我們預計增長勢頭會延續到下一季度及 2017 年。我們對市場需求總體看好，尤其是與智能手機、超級結、MOSFET、IGBT、模擬和電源管理相關的產品。”

王煜先生滿懷信心地總結道，“我們確信，華虹半導體將持續在全球 200mm 純晶圓代工廠領域扮演關鍵角色。”

## 電話會議公告

日期：二零一六年十一月四日

時間：上海時間下午四時

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

[http://www.huahonggrace.com/html/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php) 或

[https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2016\\_q3\\_earnings\\_call](https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2016_q3_earnings_call)

電話詳細：

中國	+86 800 870 0531 /+86 400 624 0406
香港	+852 3018 6768
臺灣	+886 2 7703 1751
美國	+1 347 549 4095
國際	+65 6713 5521

電話會議登入名： 99658894

密碼： HUAHONG

該電話會議廣播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都將在本新聞稿廣播後 12 個月內刊登於華虹半導體的網站上。

## 關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>

**經營業績概要**  
(以千美元為單位，每股盈利和營運數據除外)

	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
銷售收入	185,284	177,692	172,357	4.3 %	7.5 %
銷售成本	(127,749)	(122,988)	(119,681)	3.9 %	6.7 %
<b>毛利</b>	<b>57,535</b>	<b>54,704</b>	<b>52,676</b>	<b>5.2 %</b>	<b>9.2 %</b>
<b>毛利率</b>	<b>31.1%</b>	<b>30.8%</b>	<b>30.6%</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>
經營開支	(25,673)	(25,585)	(28,032)	0.3 %	(8.4)%
其他收入淨額	4,796	16,171	9,602	(70.3)%	(50.1)%
<b>稅前溢利</b>	<b>36,658</b>	<b>45,290</b>	<b>34,246</b>	<b>(19.1)%</b>	<b>7.0 %</b>
所得稅開支	(6,837)	(6,285)	(4,015)	8.8 %	70.3 %
<b>期內溢利</b>	<b>29,821</b>	<b>39,005</b>	<b>30,231</b>	<b>(23.5)%</b>	<b>(1.4)%</b>
<b>淨利潤率</b>	<b>16.1%</b>	<b>22.0%</b>	<b>17.5%</b>	<b>(5.9)</b>	<b>(1.4)</b>
每股盈利					
基本	0.03	0.04	0.03	(25.0)%	-
攤薄	0.03	0.04	0.03	(25.0)%	-
付運晶圓(仟片)	467	441	384	5.9 %	21.6 %
產能利用率 <sup>1</sup>	100.7%	95.5%	90.4%	5.2	10.3
淨資產收益率 <sup>2</sup>	2.0%	2.6%	2.0%	(0.6)	-

- 銷售收入 1.853 億美元，環比增長 4.3%，同比增長 7.5%。
- 銷售成本 1.277 億美元，環比上升 3.9%，主要由於晶圓銷售量上升所致。
- 毛利率 31.1%，環比上升 0.3 個百分點，主要由於產能利用率提升所致。
- 經營開支 2,570 萬美元，環比持平。
- 其他收入淨額 480 萬美元，環比下降 70.3%，主要由於(i) 獲得的補助減少，(ii) 匯兌損失，及 (iii) 分佔一家聯營公司盈利減少所致。
- 所得稅開支 680 萬美元，環比上升 8.8%，主要由於上一季度轉回前期計提的所得稅開支所致。
- 期內溢利 2,980 萬美元，環比下降 23.5%。
- 淨利潤率 16.1%，環比下降 5.9 個百分點。
- 每股盈利 0.03 美元，環比下降 0.01 美元，同比持平。
- 淨資產收益率 2.0%，環比下降 0.6 個百分點。

<sup>1</sup> 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

<sup>2</sup> 期內溢利 / 加權平均淨資產。

### 銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	二零一六年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第二季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
晶圓	180,388	97.4 %	173,120	97.4 %	7,268	4.2 %
其他	4,896	2.6 %	4,572	2.6 %	324	7.1 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>185,284</b>	<b>100.0 %</b>	<b>177,692</b>	<b>100.0 %</b>	<b>7,592</b>	<b>4.3 %</b>

- 本季度 97.4% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

### 銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	二零一六年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第二季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
中國 <sup>3</sup>	98,621	53.2 %	90,576	51.0 %	8,045	8.9 %
美國	35,945	19.4 %	33,689	19.0 %	2,256	6.7 %
亞洲 <sup>4</sup>	24,561	13.3 %	23,483	13.2 %	1,078	4.6 %
歐洲	16,255	8.8 %	18,716	10.5 %	(2,461)	(13.1)%
日本 <sup>5</sup>	9,902	5.3 %	11,228	6.3 %	(1,326)	(11.8)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>185,284</b>	<b>100.0 %</b>	<b>177,692</b>	<b>100.0 %</b>	<b>7,592</b>	<b>4.3 %</b>

- 本季度來自中國的銷售收入 9,860 萬美元，占銷售收入總額的 53.2%，環比增長 8.9%，主要得益於模擬、射頻及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自美國的銷售收入 3,590 萬美元，環比增長 6.7%，主要得益於通用 MOSFET 及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自亞洲的銷售收入 2,460 萬美元，環比增長 4.6%，主要得益於分立器芯片的需求增加。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,630 萬美元，環比減少 13.1%，主要由智能卡芯片的需求減少所致。
- 本季度來自日本的銷售收入 990 萬美元，環比減少 11.8%，主要由一家日本客戶的需求減少所致。

<sup>3</sup>包括香港。

<sup>4</sup>不包括中國及日本。

<sup>5</sup>包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一名主要日本客戶。

### 銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	二零一六年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第二季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
嵌入式非易失性存儲器	60,829	32.9 %	65,606	37.0 %	(4,777)	(7.3)%
分立器	52,103	28.1 %	47,913	27.0 %	4,190	8.7 %
模擬與電源管理	40,742	22.0 %	38,003	21.4 %	2,739	7.2 %
邏輯及射頻	25,460	13.7 %	20,698	11.6 %	4,762	23.0 %
獨立非易失性存儲器	5,343	2.9 %	5,030	2.8 %	313	6.2 %
其他	807	0.4 %	442	0.2 %	365	82.6 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>185,284</b>	<b>100.0 %</b>	<b>177,692</b>	<b>100.0 %</b>	<b>7,592</b>	<b>4.3 %</b>

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 6,080 萬美元，環比減少 7.3%，主要由智能卡芯片及 MCU 的需求減少所致。
- 本季度分立器銷售收入 5,210 萬美元，環比增長 8.7%，主要得益于超級結，IGBT 和通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理產品銷售收入 4,070 萬美元，環比增長 7.2%，主要得益于包括指紋傳感器在內的模擬產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻產品銷售收入 2,550 萬美元，環比增長 23.0%，主要得益于多家國內客戶的需求增加。

### 銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	二零一六年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第二季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
0.13μm 及以下	59,205	32.0 %	59,253	33.3 %	(48)	(0.1)%
0.15μm 及 0.18μm	30,776	16.6 %	28,346	16.0 %	2,430	8.6 %
0.25μm	4,728	2.6 %	4,032	2.3 %	696	17.3 %
0.35μm 及以上	90,575	48.8 %	86,061	48.4 %	4,514	5.2 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>185,284</b>	<b>100.0 %</b>	<b>177,692</b>	<b>100.0 %</b>	<b>7,592</b>	<b>4.3 %</b>

- 本季度來自 0.13μm 及以下工藝技術節點產品的銷售收入 5,920 萬美元，環比持平。
- 本季度來自 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點產品的銷售收入 3,080 萬美元，環比增長 8.6%，主要得益于包括指紋傳感器在內的模擬產品的需求增加。
- 本季度來自 0.35μm 及以上工藝技術節點產品的銷售收入 9,060 萬美元，環比增長 5.2%，主要得益于分立器芯片的需求增加。

### 銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一六年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第三季度 % (未經審核)	二零一六年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第二季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
電子消費品	123,216	66.5 %	117,042	65.9 %	6,174	5.3 %
通訊	28,039	15.1 %	30,938	17.4 %	(2,899)	(9.4)%
工業及汽車	22,769	12.3 %	19,735	11.1 %	3,034	15.4 %
計算機	11,260	6.1 %	9,977	5.6 %	1,283	12.9 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>185,284</b>	<b>100.0 %</b>	<b>177,692</b>	<b>100.0 %</b>	<b>7,592</b>	<b>4.3 %</b>

- 電子消費品及通訊仍是我們的第一及第二大終端市場分佈，本季度合計貢獻 81.6%的銷售收入，上一季度為 83.3%。
- 本季度電子消費品銷售收入 1.232 億美元，環比增長 5.3%，主要得益于模擬、射頻及通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,800 萬美元，環比減少 9.4%，主要由智能卡芯片的需求減少所致。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 2,280 萬美元，環比增長 15.4%，主要得益于智能卡芯片、MCU 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,130 萬美元，環比增長 12.9%，主要得益于 MCU 及射頻產品需求增加。

### 產能<sup>6</sup>及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	56	56	52
2 號晶圓廠	57	55	45
3 號晶圓廠	40	40	40
<b>合計</b>	<b>153</b>	<b>151</b>	<b>137</b>
<b>產能利用率</b>	<b>100.7%</b>	<b>95.5%</b>	<b>90.4%</b>

- 得益于客戶需求增加，我們的產能利用率從上季度的 95.5%上升至本季度的 100.7%。

<sup>6</sup>在期末的月產能，且為了比較目的，以 30 天作為計算基礎。

### 付運晶圓

仟片晶圓	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
付運晶圓	467	441	384	5.9%	21.6%

- 本季度付運晶圓 467 仟片，環比增長 5.9%，得益于客戶需求增加。

### 經營開支分析

以千美元計	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
銷售及分銷費用	1,633	1,721	1,688	(5.1)%	(3.3)%
管理費用 <sup>7</sup>	24,040	23,864	26,344	0.7 %	(8.7)%
<b>經營開支</b>	<b>25,673</b>	<b>25,585</b>	<b>28,032</b>	<b>0.3 %</b>	<b>(8.4)%</b>

- 本季度經營開支 2,570 萬美元，環比持平。

### 其他收入淨額分析

以千美元計	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
租金收入	2,842	3,075	3,264	(7.6)%	(12.9)%
利息收入	1,214	1,203	2,329	0.9 %	(47.9)%
匯兌(損失)/收益	(370)	3,006	4,470	(112.3)%	(108.3)%
分佔一家聯營公司溢利/(損失)	182	3,455	(668)	(94.7)%	(127.2)%
財務費用	(1,016)	(999)	(1,894)	1.7 %	(49.4)%
政府補貼	1,590	6,115	-	(74.0)%	100.0 %
其他	354	316	2,101	12.0 %	(83.2)%
<b>其他收入淨額</b>	<b>4,796</b>	<b>16,171</b>	<b>9,602</b>	<b>(70.3)%</b>	<b>(50.1)%</b>

- 其他收入淨額 480 萬美元，環比下降 70.3%，主要由於(i) 獲得的補助減少，(ii) 匯兌損失，及 (iii) 分佔一家聯營公司盈利減少所致。

<sup>7</sup>管理費用包括確認為研發開支抵消項目的政府補助。

### 現金流量分析

以千美元計	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
經營活動所得現金流量淨額	45,694	45,840	85,716	(0.3)%	(46.7)%
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(124,414)	(83,684)	22,342	48.7 %	(656.9)%
融資活動所用現金流量淨額	(1,008)	(36,939)	(1,861)	(97.3)%	(45.8)%
外匯匯率變動影響淨額	(2,995)	(13,187)	(7,162)	(77.3)%	(58.1)%
<b>現金及現金等價物變動影響淨額</b>	<b>(82,723)</b>	<b>(87,970)</b>	<b>99,035</b>	<b>(6.0)%</b>	<b>(183.5)%</b>

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 4,570 萬美元，環比持平。
- 本季度投資活動所用現金流量淨額 1.244 億美元，其中包括(i)設備投資支出 5,380 萬美元，(ii)定期存款投資支出 7,500 萬美元，部分被(i)收到用於購買設備的政府補助 370 萬美元，及(ii)利息收入 70 萬美元所抵消。
- 本季度融資活動所用現金流量淨額 100 萬美元，用於償還銀行貸款利息。

### 資本結構

以千美元計	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)	於六月三十日 二零一六年 (未經審核)
資產總額	1,916,731	1,927,406
負債總額	410,175	441,259
所有者權益總額	1,506,556	1,486,147
資產負債率 <sup>8</sup>	21.4 %	22.9 %

### 資本開支

以千美元計	二零一六年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第二季度 (未經審核)
資本開支	53,800	51,433

- 本季度資本開支 5,380 萬美元，上季度為 5,140 萬美元。

<sup>8</sup> 資產負債率=為負債總額/資產總額。

## 流動性分析

以千美元計	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)	於六月三十日 二零一六年 (未經審核)
存貨	98,760	101,270
貿易應收款項及應收票據	110,947	103,521
預付款項、按金及其他應收款項	14,554	11,810
應收關聯方款項	43,895	40,429
已凍結存款及定期存款	115,677	61,195
現金及現金等價物	375,186	457,909
<b>流動資產總額</b>	<b>759,019</b>	<b>776,134</b>
貿易應付款項	65,173	58,442
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	79,505	120,446
計息銀行借款	42,750	42,750
政府補助	47,116	51,753
應付關聯方款項	11,416	10,091
應付所得稅	19,968	14,645
<b>流動負債總額</b>	<b>265,928</b>	<b>298,127</b>
<b>淨營運資金</b>	<b>493,091</b>	<b>478,007</b>
速動比率	2.5x	2.3x
流動比率	2.9x	2.6x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	56	56
存貨周轉天數	70	75

- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 1.035 億美元上升至本季度末的 1.109 億美元，主要由于銷售收入的增加所致。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 6,120 萬美元上升至本季度末的 1.157 億美元，主要由於本季度新增 7,500 萬美元定期存款所致，部分被支付股息 2,050 萬美元所抵消。
- 貿易應付款項由上季度末的 5,840 萬美元上升至本季度末的 6,520 萬美元，主要由于材料採購的增加所致。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 1.204 億美元下降至本季度末的 7,950 萬美元，主要由於本季度(i)支付股息，(ii)應付固定資產採購款項減少，及(iii)支付半年度員工獎金所致。
- 應付所得稅由上季度末的 1,460 萬美元上升至本季度末的 2,000 萬美元，主要由於本季度計提所得稅開支所致。
- 本季度末淨營運資金 4.931 億美元，流動比率 2.9。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 56 天，環比持平。
- 本季度存貨周轉天數由上季度的 75 天縮短至本季度的 70 天，主要得益于晶圓銷售量上升。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)

華虹半導體有限公司  
簡明損益表(以千美元計, 除每股盈利和股數外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日	於六月三十日	於九月三十日
	二零一六年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一五年 (未經審核)
銷售收入	185,284	177,692	172,357
銷售成本	(127,749)	(122,988)	(119,681)
<b>毛利</b>	<b>57,535</b>	<b>54,704</b>	<b>52,676</b>
其他收入及收益	6,001	13,751	12,164
銷售及分銷費用	(1,633)	(1,721)	(1,688)
管理費用	(24,040)	(23,864)	(26,344)
其他費用	(371)	(36)	-
財務費用	(1,016)	(999)	(1,894)
分佔一家聯營公司溢利/(損失)	182	3,455	(668)
<b>稅前溢利</b>	<b>36,658</b>	<b>45,290</b>	<b>34,246</b>
所得稅開支	(6,837)	(6,285)	(4,015)
<b>期內溢利</b>	<b>29,821</b>	<b>39,005</b>	<b>30,231</b>
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	29,821	39,005	30,231
非控股權益	-	-	-
持有人應佔每股盈利			
基本	0.03	0.04	0.03
攤薄	0.03	0.04	0.03
<b>用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,033,871,656</b>	<b>1,033,871,656</b>	<b>1,033,871,656</b>
<b>用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,037,949,656</b>	<b>1,034,934,656</b>	<b>1,034,549,815</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)	於六月三十日 二零一六年 (未經審核)	於九月三十日 二零一五年 (未經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	689,290	678,183	633,940
投資物業	175,562	176,795	184,237
預付土地租賃款項	21,015	21,329	22,753
無形資產	7,427	6,987	11,710
於聯營公司的投資	42,866	42,984	42,352
可供出售投資	211,222	212,707	221,731
長期預付款項	4,639	6,519	8,719
遞延稅項資產	5,691	5,768	6,598
<b>非流動資產總額</b>	<b>1,157,712</b>	<b>1,151,272</b>	<b>1,132,040</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	98,760	101,270	84,093
貿易應收款項及應收票據	110,947	103,521	121,962
預付款項、按金及其他應收款項	14,554	11,810	13,779
應收關聯方款項	43,895	40,429	33,450
其他金融資產	-	-	122,304
已凍結存款及定期存款	115,677	61,195	23,332
現金及現金等價物	375,186	457,909	433,972
<b>流動資產總額</b>	<b>759,019</b>	<b>776,134</b>	<b>832,892</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	65,173	58,442	57,161
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	79,505	120,446	70,531
計息銀行及其他借款	42,750	42,750	61,343
政府補助	47,116	51,753	57,980
應付關聯方款項	11,416	10,091	12,514
應付所得稅	19,968	14,645	20,253
<b>流動負債總額</b>	<b>265,928</b>	<b>298,127</b>	<b>279,782</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>493,091</b>	<b>478,007</b>	<b>553,110</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>1,650,803</b>	<b>1,629,279</b>	<b>1,685,150</b>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行及其他借款	136,797	137,063	181,455
遞延稅項負債	7,450	6,069	4,219
<b>非流動負債總額</b>	<b>144,247</b>	<b>143,132</b>	<b>185,674</b>
<b>淨資產</b>	<b>1,506,556</b>	<b>1,486,147</b>	<b>1,499,476</b>
<b>權益和負債權益</b>			
股本	1,550,164	1,550,164	1,550,164
儲備	(43,608)	(64,017)	(50,688)
<b>權益總額</b>	<b>1,506,556</b>	<b>1,486,147</b>	<b>1,499,476</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日	於六月三十日	於九月三十日
	二零一六年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一五年 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量</b>			
稅前溢利	36,658	45,290	34,246
折舊及攤銷	21,166	20,483	22,038
應佔聯營公司(溢利)/虧損	(182)	(3,455)	668
營運資金的變動及其它	(11,948)	(16,478)	28,764
<b>經營活動所得現金流量淨額</b>	<b>45,694</b>	<b>45,840</b>	<b>85,716</b>
<b>投資活動所(用)/得現金流量:</b>			
購買物業、廠房及設備項目	(53,800)	(51,433)	(42,176)
其他投資活動所(用)/得的現金流量	(70,614)	(32,251)	64,518
<b>投資活動所(用)/得現金流量淨額</b>	<b>(124,414)</b>	<b>(83,684)</b>	<b>22,342</b>
<b>融資活動所用現金流量:</b>			
向股東支付股息	(20,517)	(15,401)	-
已凍結存款的減少/(增加)	20,517	(20,529)	-
已付利息	(1,008)	(1,009)	(1,861)
<b>融資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(1,008)</b>	<b>(36,939)</b>	<b>(1,861)</b>
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(79,728)	(74,783)	106,197
外匯匯率變動影響淨額	(2,995)	(13,187)	(7,162)
期初現金及現金等價物	457,909	545,879	334,937
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>375,186</b>	<b>457,909</b>	<b>433,972</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張素心(董事長)

王煜(總裁)

**非執行董事**

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

**獨立非執行董事**

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

**承董事會命**

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一六年十一月三日